

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)	浙商证券、西南证券、睿远基金等。
时间	2023年1月17日-1月18日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。</p> <p>公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。在国内通信市场需求放缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司凭借行业领先的技术实力与高效优质的服务能力，在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场，海外通信业务占比有所提升。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备良好发展前景。</p> <p>Q2、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。</p> <p>数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。2022 年前三季度，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升，促进数据中心领域营收</p>

规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力。2022 年第三季度以来，受 EGS 平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司 PCB 业务数据中心领域短期内承压。

Q3、请介绍公司 PCB 业务进入数据中心领域的竞争优势。

公司凭借在通信等传统优势领域积累的工艺技术能力和研发能力，能够满足目前市场对数据中心产品的技术要求，同时，伴随 5G 时代对信息传输速度以及传输容量的需求提升，数据中心硬件也持续向高速、大容量的方向发展，其对 PCB 在高速材料应用、加工密度以及设计层数等方面有着更高要求。公司在高速、高频等方面的技术优势可进一步得到延伸。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2022 年前三季度，伴随公司加大对汽车电子市场开发力度及南通三期工厂连线爬坡，汽车电子营收规模同比实现较大增长，但目前占 PCB 整体营收比重相对较小。2022 年第三季度，公司汽车电子 PCB 业务继续保持稳定增长。

Q5、请介绍公司南通三期工厂产能爬坡进展。

公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到四成以上。

Q6、请介绍公司封装基板业务近期下游市场需求情况。

受全球消费电子市场需求回落影响，公司部分应用于消费领域的封装基板产品需求下降，存储等非消费类应用领域的封装基板产品需求相对稳健。公司封装基板业务产能利用率较 2022 年上半年有所下降。

Q7、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。

	<p>公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看，公司封装基板业务主要面向 IDM 类（集成器件制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT 类（半导体封测商）厂商。</p> <p>Q8、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。</p> <p>相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升。</p> <p>Q9、请介绍广州封装基板项目建设进展及预计连线时间。</p> <p>公司广州封装基板项目共分两期建设，目前项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设。目前，项目总体进展推进顺利，按照正常规划将于 2023 年第四季度连线投产。</p> <p>Q10、请介绍广州封装基板项目目标产品及相关研发进展。</p> <p>公司广州封装基板项目主要面向 RF、FC-CSP 及 FC-BGA 封装基板，其中 RF、FC-CSP 封装基板均为公司相对成熟产品，并已在现有工厂实现批量化生产，FC-BGA 封装基板研发按计划推进，目前已有部分产品向客户进行送样验证。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 1 月 19 日